证券日报
2020年1月10日 星期五
制作 刘凡
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D5

(上接D4版)

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2)对公积金使用的规定

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(3)利润分配的时限

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2、近三年实际股利分配情况

2017年12月8日,公司2017年第二次临时股东大会作出决议,公司以截至2016年12月31日经审计的累计未分配利润,按照公司现有股东及股权比例,以0.35元/股(含税)现金分红3,780万元。

2018年6月25日,公司2017年度股东大会作出决议,公司以截至2017年12月31日经审计的累计未分配利润,按照公司现有股东及股权比例,以0.056元/股(含税)现金分红2,073.57万元。

截至本招股意向书摘要签署日,上述股利已全部分配完毕。

3、发行后股利分配政策

本次发行后,公司股利分配政策如下:

(1)利润分配的原则

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(2)利润分配的形式

公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润,并在具备现金分红条件下,优先考虑采用现金方式分配利润。公司原则上应当按年度将可分配利润进行分配,在不违反中国证监会、证券交易所有关规定的前提下,公司可以进行中期现金分红,中期现金分红无须审计。

(3)现金分红的条件

公司在满足以下全部条件的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%:

① 公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数;

② 公司不存在未弥补亏损,且分红年度现金流充裕,实施现金分红不会影响公司的后续经营;

③ 审计机构对公司当年的年度财务报告出具标准无保留的审计报告;

④ 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、技术改造、项目扩建、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%,或超过8,000万人民币;

⑤ 公司分红年度经审计资产负债率(合并报表口径)不超过70%。

不满足上述条件之一时,公司该年度可不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时,公司可以股票方式分配利润;公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(4)利润分配的决策程序和机制

公司每年的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩、现金流状况、未来发展规划和资金需求等因素拟定,并提请股东大会审议批准。

董事会提出的利润分配方案须经全体董事过半数表决通过,并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜,并应当通过多种途径(电话、传真、电子邮件等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司监事会应当对利润分配方案进行审议,并经半数以上监事表决通过。

公司利润分配方案提交公司股东大会审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,公司应为股东提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红预案的,董事会应当在定期报告中披露原因以及未用于现金分红的未分配利润的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况;对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(5)利润分配政策的调整程序

如果公司因自身经营状况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生较大变化,而确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,充分考虑和听取中小股东、独立董事和监事会的意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案,须经董事会全体董事过半数表决通过,并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当发表独立意见。公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议,并经半数以上监事表决通过。

公司调整利润分配政策的议案提交公司股东大会审议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,公司应为股东提供网络投票方式以方便股东参与股东大会表决。

4、本次发行前滚存利润的分配政策

公司于2018年6月召开2018年第二次临时股东大会,决定本次国内A股首次公开发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(七)发行人控股子公司情况

1、香港瑞芯微

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 瑞芯微电子(香港)有限公司 | | |
| 成立时间 | 2016年4月13日 | | |
| 住所 | 香港好景工业大厦7楼15室建发街11号屯门 | | |
| 注册资本 | 100万美元 | | |
| 实收资本 | 100万美元 | | |
| 主要管理人员 | 黄旭 | | |
| 主要业务 | 为公司的海外采购和销售平台 | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额(万美元) | 比例 |
| | 瑞芯微 | 100.00 | 100.00% |
| | 合计 | 100.00 | 100.00% |
| 最近一年及一期主要财务数据(单位:万元)(经申报会计师审计) | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2018年12月31日/2018年度 | 785.42 | 782.32 | -21.36 |
| 2019年6月30日/2019年1-6月 | 767.61 | 766.26 | -19.12 |

2、上海翰迈

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 上海翰迈电子科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2017年8月10日 | | |
| 住所 | 上海市浦东新区盛夏路500弄2号6楼整层 | | |
| 注册资本 | 1,000.00万元 | | |
| 实收资本 | 600.00万元 | | |
| 主要管理人员 | 陈锋 | | |
| 经营范围 | 电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、电子产品的研发、销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 比例 |
| | 瑞芯微 | 1,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 最近一年及一期主要财务数据(单位:万元)(经申报会计师审计) | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2018年12月31日/2018年度 | 177.23 | 152.45 | -237.38 |
| 2019年6月30日/2019年1-6月 | 97.50 | 88.97 | -263.48 |

3、杭州拓欣

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 杭州拓欣科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2017年10月12日 | | |
| 住所 | 浙江省杭州市西湖区文三路199号创业大厦418室 | | |
| 注册资本 | 1,000.00万元 | | |
| 实收资本 | 350.00万元 | | |
| 主要管理人员 | 方强 | | |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、计算机软硬件、电子集成电路、电子元器件、计算机系统集成、电子产品、通讯设备;销售:电子元器件、电子产品、计算机软硬件、通讯设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 比例 |
| | 瑞芯微 | 1,000.00 | 100.00% |
| | 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 最近一年及一期主要财务数据(单位:万元)(经申报会计师审计) | | | |
| 日期 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 2018年12月31日/2018年度 | 99.80 | 88.35 | -100.86 |
| 2019年6月30日/2019年1-6月 | 41.10 | 35.42 | -52.94 |

(八)财务报告审计截止日后主要经营状况

1、发行人2019年前三季度财务报表主要数据

公司财务报告审计截止日为2019年6月30日。申报会计师已对公司2019年前三季度财务报表出具了"天健审〔2019〕9348号"《审阅报告》,发表意见如下:"根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信福州瑞芯公司2019年第3季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映福州瑞芯公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。"

2019年1-9月,公司已经审阅的主要财务数据如下:

(1)合并资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 162,907.23 | 157,595.95 | 3.37% |
| 资产总额 | 187,761.74 | 174,060.67 | 7.87% |
| 流动负债 | 21,223.41 | 20,176.94 | 5.19% |
| 负债合计 | 23,945.34 | 22,948.87 | 4.34% |
| 所有者权益 | 163,816.40 | 151,111.79 | 8.41% |

2019年9月末,发行人经营状况良好,总资产、净资产较2018年末均有所增长。

(2)合并利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 变动幅度 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 36,540.44 | 41,017.10 | -10.91% | 93,956.01 | 96,658.40 | -2.80% |
| 营业利润 | 6,179.48 | 7,945.37 | -22.23% | 12,156.46 | 13,184.86 | -7.80% |
| 利润总额 | 6,143.42 | 8,097.24 | -24.13% | 12,741.91 | 13,348.28 | -4.54% |
| 净利润 | 6,085.66 | 7,909.23 | -23.06% | 12,686.60 | 12,980.78 | -2.27% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,085.66 | 7,909.23 | -23.06% | 12,686.60 | 12,980.78 | -2.27% |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 | 6,004.40 | 7,486.47 | -19.80% | 10,635.05 | 11,858.31 | -10.32% |

2019年7-9月,发行人营业收入较2018年同期下降10.91%,主要系2018年第三季度下游电子行业集中提前备货,导致单季度收入规模较大。同时,受研发费用增加等因素影响,2019年7-9月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较2018年同期下降19.80%。

2019年1-9月,发行人经营状况正常,业绩总体较为平稳。营业收入与2018年同期基本持平,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年同期下降1,223.26万元,降幅10.32%,主要是研发费用增加所致。

2019年1-9月,公司研发费用较2018年同期增加3,042.68万元,增幅达16.22%,主要原因为:公司不断加大新产品研发力度,2018年12月以来,公司新增研发项目较多,采用8nm、14nm制程的新一代产品相继投入研发,相应的研发投入较2018年同期增长较多。

(3)合并现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 变动幅度 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,049.93 | 10,276.96 | -11.94% | 22,911.37 | 33,390.52 | -31.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,122.75 | 5,024.82 | -659.68% | -34,615.46 | -24,412.61 | 41.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -2,073.57 | -100.00% | - | -2,073.57 | -100.00% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 1,496.60 | 1,305.86 | 14.61% | 1,741.41 | 1,893.11 | -8.01% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,576.21 | 14,534.07 | -220.93% | -9,962.67 | 8,797.44 | -213.25% |

2019年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较2018年同期下降10,479.15万元,降幅31.38%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金较2018年同期有所下降,同时支付给职工以及为职工支付的现金较2018年同期有所上升;公司投资活动产生的现金流量净额较2018年同期下降10,202.84万元,降幅41.79%,主要是购买理财产品未到期收回以及购买技术授权等长期资产支出增加所致;公司筹资活动产生的现金流量净额增加2,073.57万元,主要是2019年1-9月未进行分红。

(4)非经常性损益的主要项目

单位:万元

| 项目 | 2019年7-9月 | 2018年7-9月 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -0.03 | - | -0.03 | - |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 37.28 | 168.49 | 1,362.93 | 297.24 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 49.02 | 249.32 | 283.57 | 806.96 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | 1.77 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5.01 | 4.95 | 405.09 | 16.50 |
| 合计 | 81.26 | 422.75 | 2,051.56 | 1,122.47 |

2、发行人审计截止日后经营状况说明

公司财务报告审计截止日后的经营情况良好。2019年1-9月,公司实现营业收入93,956.01万元,与2018年同期基本持平;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年同期下降1,223.26万元,降幅10.32%,主要是研发费用增加所致。

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日期间,公司经营状况良好;公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。

3、2019年度预计经营情况

单位:万元

| 项目 | 2019年度(预计区间数) | 2018年度(经审计) | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 138,768.93—141,341.93 | 127,089.51 | 9.19%—11.21% |
| 净利润 | 19,899.76—22,649.46 | 19,215.62 | 3.56%—17.87% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 19,899.76—22,649.46 | 19,215.62 | 3.56%—17.87% |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 | 17,431.55—20,181.26 | 17,370.44 | 0.35%—16.18% |

结合公司在手订单及客户提供的销售预测,公司预计2019年度可实现营业收入138,768.93万元至141,341.93万元,较2018年度增幅为9.19%至11.21%;预计2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,431.55万元至20,181.26万元,较2018年度增幅为0.35%至16.18%,全年业绩不存在下滑的趋势。

上述全年预计数据未经申报会计师审计或审阅,不构成发行人盈利预测及利润承诺。

## 第四节 募集资金运用

一、募集资金数额及使用计划

根据公司股东大会决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于公司主营业务相关项目,具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金净额 | 备案核准情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发中心建设项目 | 5,619.16 | 5,619.16 | 闽发改备〔2018〕A010073号 |
| 2 | 新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目 | 26,657.76 | 13,563.21 | 闽发改备〔2018〕A010072号 |
| 3 | 面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目 | 14,301.21 | 12,301.21 | 闽发改备〔2018〕A010113号 |
| 4 | PMU电源管理芯片升级项目 | 2,218.53 | 2,218.53 | 闽发改备〔2018〕A010112号 |
| | 合计 | 48,796.66 | 33,702.11 | - |

在募集资金到位前,公司可结合市场情况和自身经营、财务状况,以自筹资金先行投入,在募集资金到位后,再以募集资金对先前投入的自筹资金进行置换。若实际募集资金(扣除发行费用)少于实施以上项目所需资金总额,不足部分由公司自筹解决。公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,加强对募集资金的管理,切实提高募集资金的使用效益。

二、项目发展前景分析

公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业,受到国家的鼓励与大力扶持。本次募集资金将全部用于公司主营业务,拟投资项目与公司现有业务、核心技术密切相关,符合公司的发展目标和发展战略。本次募投项目主要是在公司现有研发能力和产品系列的基础上,增加研发设备和研发人员,加大对应用处理器芯片、电源管理类芯片以及人工智能应用技术的研发力度,实现产品性能的提升、产品系列的增加和应用领域的拓展,从而提高公司市场竞争力和盈利能力。公司募投项目实施后业务模式不会发生变化,依然采用Fabless模式运营,公司芯片产品将继续专注于消费电子和智能物联应用处理器SoC芯片及电源管理芯片。

研发中心建设项目实施后,公司将构建高效技术创新平台、SoC芯片产品市场化和产业化技术支持体系,明显改善研发工作的软硬件环境,全面提升芯片设计和应用开发能力,加快新技术、新工艺、新产品的开发和应用,促进研发设计高层次人才的培养和引进,推动公司发展成为具有国际竞争力的集成电路设计企业。

新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目实施后,公司产品的性能将得到进一步的有效提升,能够更加符合物联网、互联网经济下消费者对智能产品的应用需求,进一步提升公司SoC芯片产品的附加值和竞争力,扩大芯片产品的市场占有率,有利于公司保持在消费电子产品和智能物联硬件应用处理器领域的领先地位,更好、更有效地带动传统产业的转型升级,服务、支持和促进新经济的发展。

面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目实施后,公司将进一步巩固和积累人工智能应用处理技术,并将人工智能技术应用于更多的SoC芯片产品,促进人工智能在消费电子和智能物联应用领域的产业化应用。

PMU电源管理芯片升级项目实施后,公司在电源管理类芯片研发方面的技术积累和技术深度将明显提升。支持多种协议的通用型快充芯片的研发,对公司提高电源管理芯片的市场占有率具有积极意义,对推动快充行业的标准化发展具有明显的促进作用。

综上,上述项目建成后,公司经营模式不会发生变化,研发能力、经营规模和资金实力将得到大幅增强,公司整体竞争优势更加明显,这些为公司持续经营、业务快速发展奠定了坚实的基础。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在"第一节 重大事项提示"中披露的风险因素外,本公司提醒投资者关注以下风险:

(一)人工成本上升风险

报告期内,公司的人工成本分别为17,185.52万元、18,873.08万元、21,806.06万元和10,321.53万元,呈现逐年增加的趋势。随着我国工业化、城市化进程的持续推进,劳动成本还将持续上涨,特别是知识技术型人才。未来,若公司不能通过持续开发新产品、拓展销售渠道、提升毛利率等方式抵消人工成本上升的不利影响,可能导致公司在市场竞争中处于不利地位,存在营业成本上升,市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

(二)收入季节性波动风险

2016-2018年度,公司的主营业务收入存在一定的季节性波动,第一季度销售收入较低,占比分为15.73%、15.77%和16.10%,第三、四季度销售收入较高,收入占比合计分别为59.32%、57.39%和56.22%,主要与下游终端电子产品的市场需求相关。受消费者消费习惯的影响,国庆节、"双11"、圣诞节等重大节日期间电子产品的需求相对旺盛,公司下游的设备厂商通常需要提前备货准备生产,导致在第三、四季度对芯片产品等原材料的采购需求上升。春节过后,终端电子产品销量往往出现回落,导致在一季度对芯片产品的采购需求下降。因此,公司的主营业务收入存在第一季度占比较低,第三、四季度占比较高的情况。

(三)存货跌价风险

报告期各期末,公司存货跌价准备余额分别为6,090.82万元、4,862.52万元、4,188.98万元和4,214.94万元,占存货账面余额的比例分别为15.02%、10.80%、9.04%和12.52%,存货跌价准备余额较大,主要原因为:为了保证供货的及时性和连续性,集成电路设计企业通常需要提前向晶圆厂商预定产能,提前进行备货;受消费者偏好、产品性能提升及市场竞争等因素的影响,一旦产品更新换代,未及时出售的库存就可能出现滞销的情况,容易形成大额存货跌价准备。

报告期内,公司积极拓展应用领域,产品结构持续优化,产品生命周期稳步延长,市场需求波动对公司收入的影响趋于平稳,公司经营风险有效降低,新产品出现大额存货减值的情况减少。与此同时,随着智能物联应用领域的持续涌现,对于部分销售未达预期的消费电子类芯片产品,通过投入新的研发应用到特定的智能物联应用领域以及降价售价等方式,逐步消化了前期库存。公司存货跌价准备呈现稳步下降的趋势,公司存货跌价准备余额较大的情况正在逐步改善。

未来,若市场环境发生变化、竞争加剧或是公司不能进一步拓展销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模,可能导致产品滞销、存货积压、存货可变现净值减少、存货跌价风险提高,对公司经营业绩产生不利影响。

(四)税收政策变动风险

报告期内,公司作为国家级高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税,同时享受开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按规定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。通常情况下,国家税收优惠政策具有持续性。但是,若上述税收优惠政策发生变化,或是因公司自身资质发生变化而导致不再享受税收优惠政策,将影响公司的净利润水平。

(五)汇率波动风险

报告期内,公司主营业务收入中境外收入分别为38,362.69万元、31,117.21万元、67,669.71万元和21,151.96万元,主要以美元报价和结算。报告期内,公司产生的汇兑收益分别为-112.99万元、467.55万元、1,769.23万元和270.11万元,占同期利润总额的比例分别为-1.29%、4.32%、8.94%和4.09%,对利润总额产生一定的影响。汇率受国内外政治、经济环境等众多因素影响,变动方向和波动程度存在不确定性,公司存在因汇率波动导致的汇兑损益风险。

(六)经营模式风险

公司采用Fabless经营模式,专注于从事集成电路的设计环节,有利于公司发挥自身优势,将主要资源集中在研发设计环节,专注于技术创新和新产品开发,最大程度地提高运行效率、提升竞争能力。在该经营模式下,晶圆及封装、测试厂商的工艺水平、生产能力、产品质量、交货时间等都将对公司的日常经营产生重大影响。因此,公司经营模式存在一定风险。

(七)客户较为集中的风险

报告期内,公司采用"经销为主、直销为辅"的销售模式,向前五大客户销售的金额分别为122,229.81万元、95,089.21万元、92,789.40万元和44,928.22万元,占营业收入的比例分别为94.16%、76.03%、73.01%和78.25%,客户集中度较高。公司与主要客户均已建立长期稳定的合作关系,主要客户均为行业知名电子元器件经销商或品牌商,但是仍然存在因主要客户的经营情况、资信状况发生变化而影响公司经营的风险。

(八)供应商较为集中的风险

报告期内,公司向前五大供应商采购的金额分别为82,258.33万元、72,479.58万元、67,328.54万元和16,949.78万元,占采购总额的比例分别为91.77%、92.69%、96.65%和91.00%,采购集中度较高。全球范围内知名集成电路晶圆代工厂数量较少,符合公司对技术先进性、供应稳定性和代工成本要求的代工厂商数量有限。若未来晶圆市场价格、外协加工费价格大幅上涨,或是因晶圆供货短缺、外协厂商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响芯片生产,将对公司经营业绩产生不利影响。

(九)核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累,公司掌握了一系列的核心技术,特别是在音视频编解码、影像视觉处理、软硬件协同开发、多应用平台开发等方面积累了深厚的技术优势,这些核心技术成为公司核心竞争力的重要组成部分。公司采取了严格的保密措施,并通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护,但是仍然存在因技术人员流失、技术资料被恶意留存或复制等因素导致核心技术泄露的风险。

(十)技术人才缺失风险

公司拥有一支以系统级芯片设计、算法研究为特长的研发团队,研发队伍和技术人员较为稳定,是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的主要因素之一,截至2019年6月30日,公司拥有研发人员511人,占员工总人数的74.38%。未来,若公司不能持续优化激励制度和企业文化,将无法引进更多的高端技术人才,甚至导致骨干技术人员流失。

(十一)技术授权风险

作为集成电路设计企业,为了提高研发效率,更好地发挥公司的技术特点和竞争优势,公司采取符合行业惯例的自主研发与采购IP核等技术授权相结合的研发方式。公司外购的技术授权包括IP核和EDA设计工具,受IP核和EDA设计工具市场寡头竞争格局的影响,公司技术授权供应商集中度较高,报告期内主要向ARM购买IP核技术授权,向Synopsys等购买EDA设计工具。

公司已从事集成电路设计行业近二十年,业务模式自设立以来未发生变化,公司与ARM等技术授权供应商建立了长期、稳定、共赢的合作关系,未发生IP核等技术授权到期后无法再次取得的情况。未来,若公司无法继续获取IP核和EDA技术授权,将对公司未来新产品的研发产生不利影响。

公司将持续加强对IP核等基础技术的研究和积累,努力突破公司的技术短板,同时发挥自身技术优势,继续加大对基础音频、视频、感知类深度技术的研发创新,切实提高自主研发能力。

(十二)募集资金投资项目的风险

根据募集资金投资计划,本次发行募集资金拟投资研发中心建设项目、新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目、面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC芯片的研发和产业化项目及PMU电源管理芯片升级项目,项目已经过充分论证,符合公司未来发展战略,匹配公司现有的经营模式,有利于提升公司竞争能力。本次募集资金投资项目完成后,若公司推出的新产品性能或价格不符合市场需求,将导致募集资金投资项目的效益不能如期实现。

(十三)净资产收益率下降的风险

本次发行后,公司净资产规模将大幅度提高,固定资产、无形资产及折旧摊销将相应增加,由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。

(十四)公司规模扩大引致的管理风险

本次发行完成后,公司的资产规模和业务规模将进一步扩大,员工人数、新研产品数量将相应增加,公司经营决策、组织管理、风险控制的难度也随之加大,公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险。

二、其他重要事项

(一)重大合同

截至本招股意向书摘要签署日,公司正在履行且交易金额在500万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

1、经销协议

公司采用"经销为主、直销为辅"的销售模式。在经销模式下,公司与经销商签订经销框架性协议,每笔销售再以订单形式进行,内销经销商收货或委托物流公司提货后、外销货物完成报关后,货物权利及风险转移,经销商自行承担运输、销售和库存风险。截至本招股意向书签署日,公司正在履行的主要经销框架性协议如下:

(1)2017年1月,公司与联强国际股份有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(2)2017年1月,公司与厦门建益达有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(3)2017年1月,公司与深圳扬煜科技开发有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(4)2017年1月,公司与扬宇科技有限公司(HI-Level Technology Limited)签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(5)2017年1月,公司与深圳瑞益成科技有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(6)2017年1月,公司与华商龙科技有限公司(Worldshine Technology Limited)签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(7)2017年1月,公司与深圳市华商龙商务互联科技有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(8)2017年1月,公司与大联大商贸(深圳)有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(9)2017年1月,公司与大联大商贸有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(10)2017年1月,公司与世平国际(香港)有限公司(WPI International (Hong Kong)Limited)签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(11)2017年3月,公司与欣泰亚洲有限公司签订(Syntech Asia Limited)《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(12)2017年1月,公司与科通宽带有限公司(Comtech Broadband Corporation LTD)签订《瑞芯微产品经销协议》,双方就采购及销售发行人芯片产品事宜进行了约定,协议有效期为一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。2017年11月,发行人与科通宽带有限公司(Comtech Broadband Corporation LTD)、硬蛋科技有限公司签订《参与协议》,约定发行人与硬蛋科技有限公司建立直接的协议关系,发行人与硬蛋科技有限公司双方间的权利义务关系自动依照发行人与科通宽带有限公司(Comtech Broadband Corporation LTD)签署的《瑞芯微产品经销协议》的约定执行。

2018年4月,公司与科通宽带有限公司(Comtech Broadband Corporation LTD)、硬蛋科技(深圳)有限公司、科通芯城宽带有限公司(Cogobuy Broadband Corporation limited)签订《权利义务概括转让协议》,各方约定自2018年4月起,科通宽带有限公司(Comtech Broadband Corporation LTD)在2017年1月签署的《瑞芯微产品经销协议》中的全部权利义务转让给科通芯城宽带有限公司(Cogobuy Broadband Corporation limited)。

(13)2017年1月,公司与科通宽带技术(深圳)有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(14)2017年6月,公司与福州嘉瑞数码信息技术有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。2019年6月,公司与福州嘉瑞数码信息技术有限公司、JOYROCK Technology Ltd. 签订《参与协议》,约定公司与JOYROCK Technology Ltd.建立直接的协议关系,公司与JOYROCK Technology Ltd.双方间的权利义务关系自动依照公司与福州嘉瑞数码信息技术有限公司签署的《瑞芯微产品经销协议》的约定执行。

(15)2017年9月,公司与视讯科技有限公司(Visiontek Limited)签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(16)2017年12月,公司与福州福大海矽微电子有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(17)2018年12月,公司与Fudahisi Electronics Ltd.签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

(18)2019年2月,公司与Microtech System, Inc.签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年。

(19)2019年4月,公司与奇普仕电子(深圳)有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年。

(20)2019年4月,公司与艾睿电子亚太有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年。

(21)2019年8月,公司与奇普仕(香港)有限公司签订《产品经销协议》,就其采购及销售公司芯片产品事宜进行了约定,协议有效期一年,协议期限届满,若双方无异议,可自动延续一年,延续次数不限。

2、直销协议

(1)2016年8月,公司与Samsung Electronics H.K. Co.,Ltd.签订了《产品买卖协议》,就其向公司采购芯片产品事宜进行了框架性约定,具体采购数量及单价以单独订单形式确定,协议有效期三年,协议到期前至少九十日未有任何一方通知不再续约的,协议自动续约一年。

(2)2017年6月,公司与VIVO签订了《业务合作协议》,就其向公司采购芯片产品事宜做了框架性约定,具体采购数量及单价以单独订单形式确定,协议有效期至双方重新签订相同作用的协议或双方书面同意协议失效为止。

3、晶圆代工及封装测试协议

(1)2015年6月,公司与华天科技(西安)有限公司签订了《IC封装(测试)协议》,委托其对公司提供的晶圆进行封装加工服务,期限1年,至2016年5月31日届满。期限届满前30日内,任何一方未以书面通知对方本协议期满终止的,则本协议自动延期,每次延期1年。在本协议框架下,公司每批封装加工和产品测试的数量、价格均以订单形式向其单独发出。

(2)2017年10月,公司与上海华岭集成电路技术股份有限公司签订了《委托加工合同》,委托其为公司提供封装/测试晶圆或芯片等加工服务,期限1年,至2018年10月15日届满。除非一方在合同终止前60日前书面通知对方不再续约,否则合同期限届满自动续期一年,延续次数不限。在本协议框架下,公司每批封装加工和产品测试的数量、价格均以订单形式向其单独发出。

(3)2017年12月,公司与矽品科技(苏州)有限公司签订了《委托加工合同》,委托其封装加工和产品测试,期限1年,至2018年12月21日届满。同时双方约定若双方均未于合同期限届满前60日通知对方不展期的,合同自动展期一年,合同可多次展期,每次展期均为一年。在本协议框架下,公司每批封装加工和产品测试的数量、价格均以订单形式向其单独发出。

(4)2018年3月,公司与京隆科技(苏州)有限公司签订了《委托加工合同》,委托其封装加工和产品测试,期限1年,至2019年3月1日届满。同时双方约定若双方均未于合同期限届满前60日通知对方不展期的,合同自动展期一年,合同可多次展期,每次展期均为一年。在本协议框架下,公司每批封装加工和产品测试的数量、价格均以订单形式向其单独发出。

(5)2018年11月,公司与江苏长电科技股份有限公司签订了《委托芯片封装设计及加工合同》,委托其封装加工和产品测试,期限1年,至2019年11月8日届满,若双方均未于合同期限届满前两个月通知对方不续约或重新订立合同外,合同自动展期一年,合同可多次展期,每次展期均为一年。在本协议框架下,公司每批封装加工和产品测试的数量、价格均以订单形式向其单独发出。

4、专有技术及软件许可使用协议

(1)2008年5月,公司与ARM签署《技术许可协议》,对ARM向公司授权使用其专有技术进行框架性规定,包括技术许可方式、有限使用、知识产权保证、付款方式及法律适用等内容。针对某项特定专有技术,双方另行签订单项授权合同,单项授权合同与《技术许可协议》冲突的,以单项授权合同为准。除因约定原因终止外,该《技术许可协议》长期有效。

(2)2012年12月,发行人与Mentor Graphics(Ireland) Limited签订《技术授权协议》,对Mentor Graphics(Ireland) Limited向公司授权使用其专有技术进行框架性规定,包括技术授权许可方式、有限使用、知识产权保证、付款方式及法律适用等内容。针对某项特定专有技术,双方另行签订单项授权合同,单项授权合同与《技术授权协议》冲突的,以单项授权合同为准。除因约定原因终止外,该《技术授权协议》长期有效。

(3)2017年4月,公司与Synopsys签订了采购协议,获得DWC*系列内核软件授权,本协议长期有效。

(4)2017年6月,公司与ARM公司签订技术许可合同,获得后者IP核技术使用授权,合同有效期3年。

(5)2017年6月,公司与Mentor Graphics(Ireland) Limited签订许可协议,许可发行人使用Mentor Graphics(Ireland) Limited的EDA工具使用授权,授权期限至2020年6月29日。

(6)2017年12月,公司与芯原微电子(上海)有限公司签订技术许可合同,获得VIP* Series Core的使用授权,合同有效期为3年。

(7)2018年6月,公司与ST Microelectronics International N.V.签订技术许可合同,获得IPS-WLANCW*、IPS-BT*的使用授权,合同有效期为3年。

(8)2018年11月,公司与VIVO签订合同,授权其使用视觉相关算法软件,合同有效期1年。

(9)2018年12月,公司与安谋科技签订技术许可合同,获得其IP核技术使用授权,合同有效期3年。同时,公司与安谋科技签订对应IP核技术咨询服务合同,合同有效期18个月。

公司与安谋科技、ARM签订许可协议的更替合约,三方约定由安谋科技替代ARM履行其与公司之间签署的仍在执行的许可协议。

(10)2019年1月,公司与Innovative Devices Driving Objects签订协议,获得其与*-FEM项目相关的IP核技术授权,并由其向公司交付 *-FEM技术模块,合同有效期5年。

(11)2019年2月,公司与OPPO广东移动通信有限公司签订《技术开发合作协议》,双方就OLPC芯片开发项目进行了约定,协议有效期为三年。

(12)2019年7月,2019年7月,公司与Synopsys Inc.签订协议,许可公司使用Synopsys Inc.的EDA工具使用授权,授权期限至2021年7月30日。

(13)2019年9月,公司与Cadence Design Systems (Ireland)Limited签订协议,许可公司使用Cadence Design Systems(Ireland)Limited的EDA软件工具使用授权,授权期限至2022年9月8日。

(二)重大诉讼或仲裁

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动及未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项;公司控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项;公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及刑事诉讼。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

| 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 发行人:福州瑞芯微电子股份有限公司 | 福州市鼓楼区软件大道89号18号楼 | 0591-86252506 | 0591-86252506 | 林玉秋 |
| 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 | 福州市湖东路268号证券大厦16楼 | 0591-38281701 | 0591-38281707 | 黄超 李斌 |
| 律师事务所:北京国枫律师事务所 | 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 | 010-88004488 | 010-66090016 | 郭昕 杜莉莉 |
| 会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省杭州市西溪路128号4-10层 | 0571-88216888 | 0571-88216999 | 倪国君 李宗韡 |
| 资产评估机构:坤元资产评估有限公司 | 杭州市西溪路128号901室 | 0571-88216941 | 0571-87178826 | 林蕾 闵诗阳 |
| 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 | 021-58708888 | 021-58899400 | - |
| 拟上市的股票交易所:上海证券交易所 | 上海市浦东南路528号证券大厦 | 021-68808888 | 021-68804868 | - |
| 收款银行: | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 |

二、发行上市重要日期

| 事项 | 时间 |
|---|---|
| 询价推介时间 | 2020年1月14日 |
| 定价公告刊登日期 | 2020年1月17日 |
| 申购日期 | 2020年1月20日 |
| 缴款日期 | 2020年1月22日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |

## 第七节 备查文件

招股意向书全文、备查文件可到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住所查阅。

一、查阅时间:工作日上午9:00—11:00,下午1:30—4:30。

二、查阅地点:

1、福州瑞芯微电子股份有限公司

住所:福州市鼓楼区软件大道89号18号楼

电话:0591-86252506

传真:0591-86252506

2、兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号证券大厦16楼

电话:0591-38281701

传真:0591-38281707

招股意向书全文、备查文件可以通过上海证券交易所指定网站查阅,网址:http://www.cninfo.com.cn

福州瑞芯微电子股份有限公司

2020年1月10日